

1. Record Nr.	UNISA996213594903316
Titolo	2012 3rd IEEE International Workshop on Low Temperature Bonding for 3D Integration
Pubbl/distr/stampa	[Place of publication not identified], : IEEE, 2012
ISBN	1-4673-0742-4
Descrizione fisica	1 online resource (262 pages) : illustrations
Disciplina	621.36
Soggetti	Photonics - Materials Three-dimensional integrated circuits Sealing (Technology)
Lingua di pubblicazione	Inglese
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia
Note generali	Bibliographic Level Mode of Issuance: Monograph